



Mate 2008 第14回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」
シンポジウム参加者募集

主 催：（社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共 催：（社）機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会，（社）高温学会 微細加工研究情報委員会，（社）日本塑性加工学会 接合・複合分科会，（社）日本電気制御機器工業会，エレクトロニクス生産科学学会準備会，レーザ加工学会，大阪大学 先端科学イノベーションセンター
協 賛：映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学工学会，画像電子学会，軽金属学会，計測自動制御会，高温学会，高分子学会，資源・素材学会，システム制御情報学会，情報処理学会，精密工学会，電気化学会，電気学会，電気設備学会，電子情報通信学会，日本機械学会，日本金属学会，日本顕微鏡学会，日本材料学会，日本シミュレーション学会，日本接着学会，日本セラミックス協会，日本塑性加工学会，日本電気制御機器工業会，日本伝熱学会，日本非破壊検査協会，日本表面科学会，日本品質管理学会，日本複合材料学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本溶接協会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会

開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は，この20年間，高機能化，高信頼化，小型化，低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下，日本の高度成長を牽引してきました．今後も日本が世界を先導し続けるには，生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと，既存の学問領域，設計・生産技術などの領域を越えて，エレクトロニクスを取巻く科学技術，経営・生産システム，価値システム，などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています．本シンポジウムでは，これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち，生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます．

日 時：平成20年2月5日（火）8:50～17:50
平成20年2月6日（水）9:00～17:30

会 場：パシフィコ横浜 会議センター
5階（小ホール，501，502，414，415）
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1
TEL: 045-221-2121

シンポジウム参加登録費（論文集代を含む）

- 主催・共催団体登録会社：20,000円
- 協賛学協会会員会社：30,000円
- 論文口頭発表者：15,000円
- 大学，国公立研究機関：10,000円
- 学生：5,000円
- その他（一般）：40,000円

シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウムURLより平成20年1月25日（金）までに参加登録を行って下さい．

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2008.html>

参加受付証はプリントアウトの上，当日ご持参下さい．参加費のお支払いは，銀行振込・現金書留のいずれかでお願ひ致します．

問合せ，申込先：Mate 2008 事務局 事務代行
合同会社フロンティア・アライアンス
ものづくりリエゾンオフィス内
TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568
E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日：平成20年1月25日（金）

振込先銀行：三井住友銀行 千里中央支店
口座番号：普通No.0837623
口座名義：Mate 受付事務局

シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2008.html>

プログラム（セッション名と発表件数）

2月5日（火）8:50～17:50（18:00～懇親会）

◆プレナリーセッション

「日本のものづくりの国際競争力」（仮題）

（東京大学ものづくり経営研究センター 小川紘一）

「超精密限界への挑戦」

（㈱ニコン 精機カンパニー開発本部 馬立稔和）

「車載モジュールの差別化戦略」

（㈱デンソー EHV機器事業部 水野哲哉）

「デジタル素材分野」

（依頼中）

2月5日（火）8:50～17:50	2月6日（水）9:00～17:30
[A-1] めれ・溶食（4件） [A-2] 界面反応・解析技術Ⅰ（4件） [A-3] 界面反応・解析技術Ⅱ（4件） [B-1] ナノ粒子接合（4件） [B-2] パンプ実装（5件） [B-3] パンプ実装／信頼性（5件） [C-2] 固相接合（5件） [C-3] 薄膜（5件）	[A-4] 鉛フリー（4件） [A-5] ソルダリング材料（5件） [A-6] 熱疲労信頼性（5件） [A-7] 評価・信頼性（4件） [B-4] 基板・樹脂（4件） [B-5] MEMS・微細加工（5件） [B-6] レーザ微細加工（5件） [B-7] パッケージ開発（4件） [C-4] 開発（5件） [C-5] 開発・設計（4件） [C-6] 樹脂材料（5件） [C-7] 検査・評価技術（4件） （一般論文発表合計90件）